

2020年3月期決算 セグメント情報

2020年5月18日
日本ガイシ株式会社



20年3月期 連結決算概要

(億円)	19年3月期	20年3月期	前期比
売上高	4,635	4,420	為替影響 △68 △5%
営業利益	647	550	△16 △15%
経常利益	644	520	△19%
親会社株主に帰属する 当期純利益	355	271	△24%
換算レート	ドル 111円 ユーロ 128円	109円 121円	△2円 △7円

前期比 減収減益

- 電力関連 国内外でがいし需要が減少。海外拠点閉鎖に伴う費用減等により赤字縮小。
- セラミクス 排ガス規制強化に伴いGPF（ガソリン・パーティキュレート・フィルター）の需要が増加したものの、自動車の生産・販売台数の減少や為替円高の影響により売上高は前期並み。利益は減価償却費の増加等により減益。
- エレクトロニクス セラミックパッケージの物量減少や、双信電機の低調により減収・微増益。
- プロセステクノロジー 主に半導体製造装置用製品の需要が減少し前期比減収・減益。
- 特別損失 20年3月期は固定資産減損126億円を計上。（タイ97億円、パッケージ22億円等）（19年3月期は固定資産減損109億円、事業損失30億円を計上。）



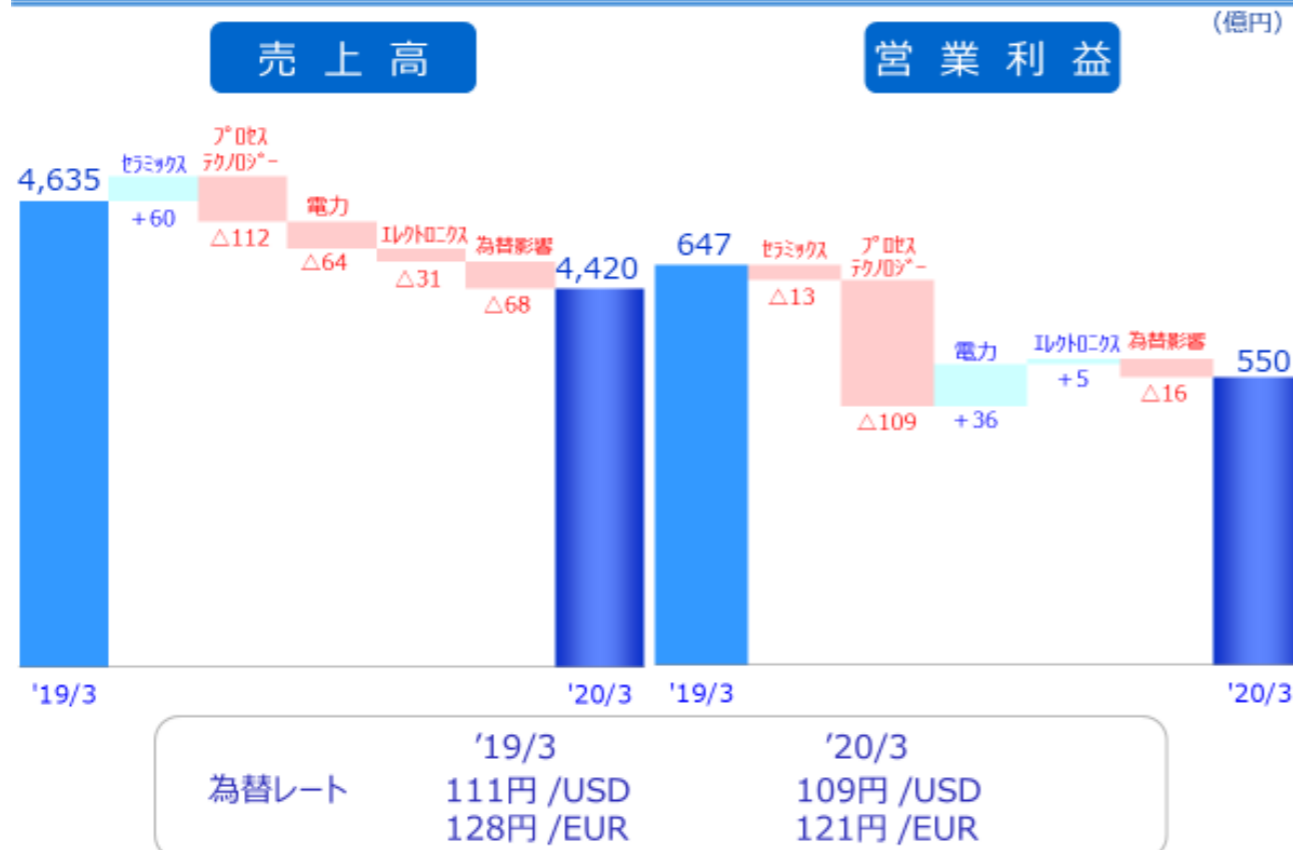
事業別売上高（通期）

(億円)

<セグメント間売上消去後>	18年3月期	19年3月期	20年3月期
がいし	525	467	408
NAS	19	32	25
電力関連合計	544	498	433
ハニカム	779	760	698
GPF	765	108	207
Cd-DPF・大型ハニカム		695	638
SIC-DPF	408	390	399
センサー	454	562	576
セラミクス合計	2,407	2,514	2,518
金属	225	223	194
電子部品	284	263	271
双信電機	104	102	90
エレクトロニクス合計	613	588	554
産業プロセス	271	310	261
半導体製造装置セラミクス	676	725	653
プロセステクノロジー合計	947	1,035	915
全社合計	4,511	4,635	4,420



20年3月期 対前年増減



事業別売上高（上期・下期）

(億円)

<セグメント間売上消去後>	19年3月期		20年3月期	
	上期	下期	上期	下期
がいし	231	236	202	205
NAS	11	21	4	21
電力関連合計	242	257	206	227
ハニカム	384	376	372	327
GPF	381	421	93	114
Cd-DPF・大型ハニカム			342	297
SIC-DPF	188	202	188	211
センサー	273	289	288	288
セラミクス合計	1,226	1,288	1,282	1,236
金属	108	115	99	95
電子部品	142	121	140	131
双信電機	52	50	44	46
エレクトロニクス合計	302	286	283	272
産業プロセス	134	175	129	133
半導体製造装置セラミクス	376	349	298	355
プロセステクノロジー合計	510	524	427	488
全社合計	2,280	2,355	2,198	2,222